

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-059067

(43)Date of publication of application : 26.02.2002

(51)Int.Cl.

B05C 11/08

B05D 1/40

G02F 1/13

(21)Application number : 2000-245645

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 14.08.2000

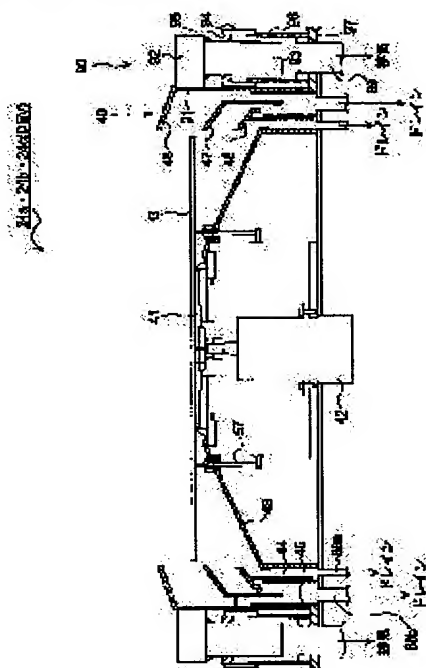
(72)Inventor : MIYAZAKI KAZUHITO
YAHIRO SHUNICHI

(54) LIQUID TREATMENT DEVICE AND LIQUID TREATMENT METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid treatment device and a liquid treatment method which can give a high quality substrate stuck with a smaller amount of particles by reducing the generation of mist in a spinner-type liquid treatment device.

SOLUTION: The liquid treatment device is provided with a holding means (a spin chuck) 41 holding a substrate G on it, a treating liquid supply means supplying a specified treating liquid to the substrate G, a rotation driving mechanism 42 which rotates the substrate G with the spin chuck 41 in a plane, a treating cup unit 49 having an outer cup 48 the inner wall of which is in a nearly dried state in the beginning of a spin-drying treatment of the substitute G, and which is arranged to enclose the substrate G for the use in the stage of the spin-drying treatment, and a lifting mechanism 50 for the treatment cup unit 49.



* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]Liquid treatment devices comprising:

Holding mechanism which lays and holds a substrate.

A treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism.

A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism.

An exhauster style allocated by peripheral wall of a cup allocated so that a substrate held at said holding mechanism might be surrounded, and said cup.

[Claim 2]Liquid treatment devices comprising:

Holding mechanism which lays and holds a substrate.

A treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism.

A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism.

A treatment cup unit allocated so that a substrate held at said holding mechanism might be surrounded, They are liquid treatment devices which possess a rising and falling mechanism which makes it go up and down said treatment cup unit, rotate a substrate after supplying a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, and perform spin drying, A cup arranged at a position which surrounds a substrate which said treatment cup unit has been arranged at a position maintained by abbreviated dryness in the case of liquid treatment, and was held at said holding mechanism on the occasion of said spin drying.

[Claim 3]The liquid treatment devices according to claim 2, wherein an exhauster style is allocated by peripheral wall of said cup.

[Claim 4]The liquid treatment devices according to claim 1 or 3 characterized by forming an exhaust route in said exhauster style so that an air current produced by rotation of said substrate may be inhaled in a forward direction.

[Claim 5]Liquid treatment devices comprising:

Holding mechanism which lays and holds a substrate.

A treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism.

A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism.

A treatment cup unit of 3-fold structure which is allocated so that said substrate may be surrounded, and consists of an inner cup formed from the inside so that height might become high one by one toward the outside, an inside cup, and an outer cup, and a rising and falling mechanism of said treatment cup unit.

[Claim 6]Liquid treatment devices comprising:

Holding mechanism which lays and holds a substrate.

A treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism.

A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism.

A treatment cup unit of 3-fold structure which is allocated so that said substrate may be surrounded, and consists of an inner cup formed from the inside so that height might become high one by one toward the outside, an inside cup, and an outer cup, a rising and falling mechanism of said treatment cup unit, and an exhaustor style provided in a peripheral wall of said outer cup.

[Claim 7]The liquid treatment devices according to claim 6 characterized by forming an exhaust route of said exhaustor style so that an air current produced by rotation of said substrate may be inhaled in a forward direction.

[Claim 8]Liquid treatment devices given in any 1 paragraph of claim 5 to claim 7 characterized by coming to form said treatment cup unit in [said inner cup, said inside cup, and said outer cup] one.

[Claim 9]When rotating a substrate and performing spin drying, after supplying a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, in order to collect treating solutions which disperse from a substrate, said outer cup, Liquid treatment devices given in any 1 paragraph of claim 5 to claim 8 arranging at a position which surrounds a substrate.

[Claim 10]A cup used in order to be a liquid treating method performed to a substrate by supplying a predetermined treating solution and to collect treating solutions which disperse from a substrate during supply of said treating solution, rotating in a field a substrate held at an abbreviated level, A liquid treating method using properly a cup in the state where an internal surface used in order to collect treating solutions which disperse from a substrate, when rotating a substrate and performing spin drying after supply interruption of said treating solution abbreviated-dried.

[Claim 11]The liquid treating method according to claim 10 performing said spin drying providing an exhaustor style in a peripheral wall of a cup used at the time of said spin drying, operating said exhaustor style, and performing exhaust air out of said treatment cup unit.

[Claim 12]A liquid treating method performed to said substrate by supplying a predetermined treating solution while rotating in a field a substrate characterized by comprising the following held at an abbreviated level.

An inner cup formed from the inside so that height might become high one by one toward the outside, The 1st recovery process that collects treating solutions which disperse from a substrate which will rotate by the time it allocates a treatment cup unit of 3-fold structure which consists of an inside cup and an outer cup so that a substrate may be surrounded, and it goes through predetermined time from a rotation start of said substrate with said inner cup. The 3rd recovery process that collects treating solutions which disperse from a substrate when rotating a substrate and performing spin drying after suspending the 2nd recovery process that collects treating solutions which disperse from a substrate which rotates after said 1st recovery process before supply interruption of said treating solution from said inside cup, and supply of said treating solution with said outer cup.

[Claim 13]The liquid treating method according to claim 12 performing said 3rd recovery process allocating an exhaustor style in a peripheral wall of said outer cup, operating said exhaustor style, and performing exhaust air out of said treatment cup unit.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention relates to spinner type the liquid treatment devices and the liquid treating method which perform predetermined liquid treatment, for example to substrates, such as a glass substrate for liquid crystal displays (LCD), and a semiconductor wafer.

[0002]

[Description of the Prior Art]For example, in the photo lithography process of a liquid crystal display (LCD) or a semiconductor device, using the liquid treatment devices generally called a spinner type, spin rotation of the substrates, such as an LCD substrate and a semiconductor wafer, is carried out in a field, and processing of washing, a resist application, development, etc. is performed.

[0003]For example, in the development of an LCD substrate, the substrate by which exposing treatment was carried out is laid in a spin chuck etc., It fixes and the liquid peak of the developing solution is carried out on a substrate, a paddle is formed, a development reaction is advanced, supply of a rinse is started, a developing solution and a rinse are shaken off at the same time it rotates a substrate after carrying out specified time elapse, and spin drying which suspends supply of a rinse after that and rotates a substrate at high speed is performed. Thus, in spinner type liquid treatment devices, it is rotating a substrate and dispersing a treating solution from a substrate to the four quarters, and a treating solution is shaken off.

[0004]Thus, the treating solution shaken off from the substrate collided with the internal surface of the treatment cup unit provided so that a substrate might be surrounded, was led below, and was collected or discarded through the drain. The inner cup arranged so that a substrate may be surrounded, when rotating a substrate as a treatment cup unit at a low speed, the outer cup arranged so that a substrate may be surrounded, when performing spin drying which rotates a substrate at high speed, and the thing which has the dual structure, ** and others, were mainly used.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]However, when the treatment cup unit of the conventional dual structure is used. If it is made to rotate at high speed for desiccation of a substrate after the treating solution shaken off from the substrate had adhered to both the internal surfaces of an inner cup and an outer cup and having been surrounded by the inner cup or the outer cup, This mist soared to up to the substrate, and it became particle, and adhered [the air current generated by rotation generated mist from the treating solution adhering to the internal surface of the inner cup or the outer cup and] to the substrate, and there was a problem on which the quality of a substrate is reduced.

[0006]This invention is made in view of the technical problem which this conventional technology has, and is a thing.

The purpose is to provide the liquid treatment devices and the liquid treating method which reduce generating of the mist in the liquid treatment devices of **, and close offer of a quality substrate with little coating weight of particle if possible.

[0007]

[Means for Solving the Problem]Holding mechanism which this invention lays a substrate as the 1st invention, and is held in order to solve an aforementioned problem, A treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, Liquid treatment devices possessing a pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism, a cup allocated so that a substrate held at said holding mechanism might be surrounded, and an exhaustor style allocated by peripheral wall of said cup are provided.

[0008]Holding mechanism which this invention lays a substrate as the 2nd invention, and is held, and a treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism, A treatment cup unit allocated so that a substrate held at said holding mechanism might be surrounded, They are liquid treatment devices which possess a rising and falling mechanism which makes it go up and down said treatment cup unit, rotate a substrate after supplying a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, and perform spin drying, Said treatment cup unit provides liquid treatment devices having a cup which is arranged at a position maintained by abbreviated dryness in the case of liquid treatment, and is arranged at a position which surrounds a substrate held at said holding mechanism in the case of said spin drying.

[0009]Holding mechanism which this invention lays a substrate as the 3rd invention, and is held, and a treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism, A treatment cup unit of 3-fold structure which is allocated so that said substrate may be surrounded, and consists of an inner cup formed from the inside so that height might become high one by one toward the outside, an inside cup, and an outer cup, Liquid treatment devices possessing a rising and falling mechanism of said treatment cup unit are provided.

[0010]Holding mechanism which this invention lays a substrate as the 4th invention, and is held, and a treating solution feed mechanism which supplies a predetermined treating solution to a substrate held at said holding mechanism, A pivot means which rotates a substrate so that a substrate may carry out the field internal version with said holding mechanism, A treatment cup unit of 3-fold structure which is allocated so that said substrate may be surrounded, and consists of an inner cup formed from the inside so that height might become high one by one toward the outside, an inside cup, and an outer cup, Liquid treatment devices possessing a rising and falling mechanism of said treatment cup unit and an exhaustor style provided in a peripheral wall of said outer cup are provided.

[0011]this invention -- as the 5th invention -- abbreviated -- with a cup used in order to be a liquid treating method performed to a substrate by supplying a predetermined treating solution and to collect treating solutions which disperse from a substrate during supply of said treating solution, rotating in a field a substrate held horizontally. An internal surface used in order to collect treating solutions which disperse from a substrate, when rotating a substrate and performing spin drying after supply interruption of said treating solution provides a liquid treating method using properly a cup in the state where it abbreviated-dried.

[0012]This invention is a liquid treating method performed to said substrate by supplying a predetermined treating solution while rotating in a field a substrate held at an abbreviated level as the 6th invention, An inner cup formed from the inside so that height might become high one by one toward the outside, The 1st recovery process that collects treating solutions which disperse from a substrate which will rotate by the time it allocates a treatment cup unit of 3-fold structure which consists of an inside cup and an outer cup so that a substrate may be surrounded, and it goes through predetermined time from a rotation start of said substrate with said inner cup, The 2nd recovery process that collects treating solutions which disperse from a substrate which rotates after said 1st recovery process before supply interruption of said treating solution from said inside cup, When rotating a substrate and performing spin drying after suspending supply of said treating solution, a liquid treating method having the 3rd recovery

process that collects treating solutions which disperse from a substrate with said outer cup is provided.

[0013]According to such liquid treatment devices and a liquid treating method, since it is exhausted by exhaustor style provided in a peripheral wall of a cup even if mist of a treating solution occurs during liquid treatment, it becomes possible to prevent dance going up in the substrate sky of mist, and to prevent adhesion of particle in a substrate. By surrounding a substrate with an outer cup in a case of having become a cup which has an internal surface in abbreviated dryness at the time of spin drying, for example, 3-fold structure, generating of mist is prevented and it also becomes possible to reduce mist quantity which soars to the sky of a substrate. In this case, if exhaust air from a peripheral wall of a cup is performed further, mist can be exhausted more effectively. Thus, by obtaining a substrate of high quality with little adhesion of particle, a product defect is reduced and reliability is improved.

[0014]

[Embodiment of the Invention]Hereafter, with reference to an accompanying drawing, an embodiment of the invention is described in detail. Drawing 1 is a top view showing the resist application and the development processing system 100 of the LCD substrate which has the development units (DEV) 24a-24c which are one embodiments of the liquid treatment devices of this invention.

[0015]The cassette station 1 in which a resist application and the development processing system 100 lay the cassette C which accommodates two or more LCD substrate (substrate) G, The treating part 2 provided with two or more handling units for performing a series of processings which include a resist application and development in the substrate G, It has the interface part 3 for delivering the substrate G between exposure devices (not shown), and the cassette station 1 and the interface part 3 are arranged to the both ends of the treating part 2, respectively.

[0016]The cassette station 1 is provided with the conveyer style 10 for conveying the substrate G between the cassette C and the treating part 2. And carrying-in appearance of the cassette C is performed in the cassette station 1. In the carrying path 10a top in which the conveyer style 10 was formed along the arrangement direction of a cassette, it has the movable transportation arm 11 and conveyance of the substrate G is performed by this transportation arm 11 between the cassette C and the treating part 2.

[0017]The treating part 2 is divided into the pre-stage 2a, middle part 2b, and the post-stage 2c, it has the carrying paths 12, 13, and 14 in the center, respectively, and each handling unit is allocated in the both sides of these carrying paths. And the relay parts 15 and 16 are formed among these.

[0018]The pre-stage 2a is provided with the movable main conveying machine 17 in accordance with the carrying path 12, and to the one side of the carrying path 12. The two washing units (SCR) 21a and 21b are arranged, To the other side of the carrying path 12, a UV irradiation unit. The processing block 27 which the processing block 25 which (UV) and the refrigeration unit (COL) put on two steps, the processing block 26 which a heating unit (H.P.) comes to put on two steps, and a refrigeration unit (COL) come to put on two steps is arranged.

[0019]Middle part 2b is provided with the movable main conveying machine 18 in accordance with the carrying path 13, and to the one side of the carrying path 13. a resist coating treatment unit -- (--- CT ---) --- 22 --- and --- a substrate --- G --- an edge part --- resist --- removing --- a periphery --- resist removal --- a unit --- (--- ER ---) --- 23 --- one ---like --- providing --- having --- **** --- a carrying path --- 13 --- the other side --- ****. A heating unit. The processing block 28 which (H.P.) comes to put on two steps, The processing block 29 which a heating unit (H.P.) and a cooling process unit (COL) come to pile up up and down, and the processing block 30 which an adhesion process unit (AD) and a refrigeration unit (COL) come to pile up up and down are arranged.

[0020]The post-stage 2c is provided with the movable main conveying machine 19 in accordance with the carrying path 14, and to the one side of the carrying path 14. The three development units (DEV) 24a, 24b, and 24c are arranged, The processing block 31 which a heating unit (H.P.) comes to put on two steps, and the processing blocks 32 and 33 which both heating units (H.P.)

and cooling process units (COL) come to pile up up and down are arranged at the other side of the carrying path 14.

[0021]On both sides of a carrying path, the treating part 2 to one side The washing unit (SCR) 21a, It has structure which arranges only a spinner system unit like the resist coating treatment unit (CT) 22 and the development unit (DEV) 24a, and arranges only heat system handling units, such as a heating unit (H.P.) and a cooling process unit (COL), to the another side side.

[0022]The drug solution supply unit 34 is arranged and the space 35 for maintaining the main conveying machines 17, 18, and 19 further is provided for the portion by the side of spinner system unit arrangement of the relay parts 15 and 16.

[0023]The main conveying machines 17, 18, and 19 are provided with X axis driving of the 2-way within the level surface, Y axis driving, and vertical Z axis driving, respectively, are provided with the rotary drive which rotates focusing on the Z-axis further, and have an arm which supports the substrate G, respectively.

[0024]The main conveying machine 17 has carrying in and taking out of the substrate G to each handling unit of the pre-stage 2a, and the function to deliver the substrate G between the relay parts 15 further while it has the transportation arm 17a and delivers the substrate G between the transportation arms 11 of the conveyer style 10. The main conveying machine 18 has the transportation arm 18a, and it has carrying in and taking out of the substrate G to each handling unit of middle part 2b, and the function to deliver the substrate G between the relay parts 16 further while it delivers the substrate G between the relay parts 15. The main conveying machine 19 has the transportation arm 19a, and it has carrying in and taking out of the substrate G to each handling unit of the post-stage 2c, and the function to deliver the substrate G between the interface parts 3 further while it delivers the substrate G between the relay parts 16. The relay parts 15 and 16 function also as a cooling plate.

[0025]The interface part 3 is provided with the following.

The extension 36 which holds the substrate G temporarily [when delivering the substrate G between the treating parts 2].

The two buffer stages 37 which were furthermore established in the both sides and which arrange a buffer cassette.

The conveyer style 38 which performs carrying-in appearance of the substrate G between these and an exposure device (not shown).

In the carrying path 38a top in which the conveyer style 38 was formed along the arrangement direction of the extension 36 and the buffer stage 37, it has the movable transportation arm 39 and conveyance of the substrate G is performed by this transportation arm 39 between the treating part 2 and an exposure device.

[0026]Thus, by collecting each handling unit and unifying, space-saving-izing and the increase in efficiency of processing can be attained.

[0027]In the resist application and the development processing system 100 constituted in this way, The substrate G in the cassette C is conveyed by the treating part 2, and in the treating part 2. Surface treatment and washing processing are first performed by the UV irradiation unit (UV) of the processing block 25 of the pre-stage 2a, After being cooled in a cooling process unit (COL), scrubber washing is performed with the washing units (SCR) 21a and 21b, and after stoving is carried out with one heating unit of the processing blocks 26 (H.P.), it is cooled with one refrigeration unit (COL) of the processing blocks 27.

[0028]Then, in order for the substrate G to be conveyed by middle part 2b and to improve the fixability of resist, Hydrophobing processing (adhesion promoter coat) is carried out with the adhesion process unit (AD) of the upper row of the processing block 30, Resist is applied with the resist coating treatment unit (CT) 22 after cooling in the cooling process unit (COL) of the lower berth, and resist with an excessive periphery of the substrate G is removed by the periphery resist removal unit (ER) 23. Then, prebaking processing is carried out by one of the heating units (H.P.) in middle part 2b, and the substrate G is cooled with the refrigeration unit (COL) of the lower berth of the processing block 29 or 30.

[0029]Then, the substrate G is conveyed by the exposure device via the interface part 3 with the main conveying machine 19 from the relay part 16, and a predetermined pattern is exposed

there. And after carrying in the substrate G via the interface part 3 again and performing post exposure baking treatment if needed with one heating unit of the processing blocks 31, 32, and 33 of the post-stage 2c (H.P.), A development is carried out with either of the development units (DEV) 24a, 24b, and 24c, and a predetermined circuit pattern is formed. After postbake processing was performed with one heating unit of the post-stages 2c (H.P.) to the substrate G by which the development was carried out, It is cooled with one of refrigeration units (COL), and is accommodated in the predetermined cassette on the cassette station 1 by the main conveying machines 19, 18, and 17 and the conveyer style 10.

[0030]Next, the development units (DEV) 24a-24c concerning this invention are explained in detail. Drawing 2 is a sectional view of a development unit (DEV), and drawing 3 is a top view of the development units (DEV) 24a-24c. As shown in drawing 3, the various members which constitute the development units (DEV) 24a-24c are allocated in the sink 59.

[0031]In [as shown in drawing 2] the development units (DEV) 24a-24c, It is provided so that the holding mechanism 41 held mechanically, for example, a spin chuck, may rotate the substrate G with the rotary drives 42, such as a motor, and the covering 43 which surrounds the rotary drive 42 is arranged at this spin-chuck 41 bottom. Rise and fall of the spin chuck 41 are attained according to the rising and falling mechanism which is not illustrated, and it delivers the substrate G between the transportation arms 19a in an ascending position. The spin chuck 41 has come to be able to carry out adsorption maintenance of the substrate G with vacuum suction etc.

[0032]Two or more attitude control pins 57 of the substrate G are allocated so that some coverings 43 may be penetrated. Since formation of a developing solution paddle becomes difficult when it is easy to bend with prudence and the surface turns into a curved surface as a result, the peripheral part of the substrate G adjusts the height of the attitude control pin 57, and it performs attitude control in support of the substrate G so that the surface of the substrate G may serve as an abbreviated level from the substrate G bottom. For this reason, the attitude control pin 57 is connected with the rising and falling mechanism which is not illustrated. After the attitude control pin 57 has supported the substrate G, since the substrate G cannot be rotated, in rotating the substrate G with the spin chuck 41, the attitude control pin 57 is dropped by rotation start at the latest, and it is isolated from the substrate G.

[0033]Although the position of the attitude control pin 57 is fixed and how to cancel bending of the substrate G by adjusting the height of the spin chuck 41 is also considered, the problem that regulation when deviation arises is not easy for the fixed height of the attitude control pin 57 in that case arises. When raising the spin chuck 41 so that the substrate G may separate from the attitude control pin 57 in order to shake off the developing solution on the substrate G after forming a developing solution paddle on the substrate G, It is apprehensive about a difference partial to the pattern developed by a difference partial to the gestalt of a developing solution paddle arising arising etc. However, such a problem will not be produced if the attitude control pin 57 is constituted enabling free rise and fall.

[0034]The two under cups 44 and 45 are estranged and formed in the periphery of the covering 43, and in the inner circumference side upper part of the inside under cup 44. The inner cup (inner cup) 46 for leading the developing solution in which it was mixed with the developing solution and rinse which disperse from the substrate G, and concentration fell slightly to the drain 88a formed in the inner circumference side pars basilaris ossis occipitalis of the under cup 44 is formed. By the drain 88a being open for free passage to the cross valve which is not illustrated, and the developing solution from the substrate G shaking, and changing a 3 in all way valve to the timing of supply of a cutoff rinse, The developing solutions in which the developing solution and rinse in which a rinse is hardly mixed were mixed, and concentration became thin can be separated and collected now.

[0035]The inside cup (middle cup) 47 for leading the rinse which mainly disperses from the substrate G above [between the two under cups 44.45] to the drain 88b in which it was provided by the pars basilaris ossis occipitalis between the under cups 44.45 is formed. The drain 88b is used also for the exhaust air in the treatment cup unit 49 of 3-fold structure which consists of the inner cup 46, the inside cup 47, and the outer cup 48 mentioned later.

[0036]The outer cup (outer cup) 48 for mainly leading the mist of a rinse to the drain 88b or the exhaust port 89 mentioned later is allocated in the periphery side upper part of the outside under cup 45. Inner cup 46, inside cup 47, and the outer cup 48 have the taper part toward which each inclined, and the peripheral wall (side wall) set up by the abbreviated perpendicular, and constitutes the treatment cup unit 49 which is connected mutually and has 3-fold structure. In order to show the composition of such a treatment cup unit 49, on the right-hand side of drawing 2, In order to show a pore for the treating solution to collect to flow and fall, inner cup 46, inside cup 47, and the outer cup 48 are shown by the different body, and on the other hand, on the left-hand side of drawing 2, In order to show that inner cup 46, inside cup 47, and the outer cup 48 are constituted in one, the gestalt which showed the joining section is shown.

[0037]Now, as shown in drawing 3, the rise-and-fall drive mechanism 50 is allocated in four places of the direction of a cross joint by the periphery of the outer cup 48. It is possible to perform ascent and descent operation of the treatment cup unit 49 in response to the signal from the control device 70 mentioned later, and to stop and hold the treatment cup unit 49 to a predetermined height position. In this way, by adjusting the height position of inner cup 46, inside cup 47, and the outer cup 48, and using the drains 88a and 88b properly according to the timing of a development, As mentioned above, the rinse in which a deep developing solution, the thin developing solution in which the rinse was mixed, a rinse, and a little developing solutions were mixed is independently recoverable.

[0038]As shown in drawing 2 and drawing 3, the exhauster style 90 is allocated in four places of the direction of a cross joint by the peripheral wall of the outer cup 48. Operate this exhauster style 90 so that inhalation of air may be performed from the inside of the treatment cup unit 49, when collecting the treating solutions which mainly disperse from the substrate G using the outer cup 48. When treating solutions are being collected using the inner cup 46 and the inside cup 47, it is possible by performing inhalation-of-air operation to perform pumping including mist.

[0039]Here, the composition of the exhauster style 90 is explained. The inlet port 91 is formed in the peripheral wall of the outer cup 48, it is open for free passage to the inlet port 91, and the 1st introducing pipe 92 is allocated, The 2nd introducing pipe 93 for drawing below the air current introduced into the 1st introducing pipe 92 is opened for free passage and formed in the 1st introducing pipe 92, and the exhaust port 89 is further formed under the 2nd introducing pipe 93. In this way, the exhauster style 90 performs the side exhaust air which lets the peripheral wall of the outer cup 48 pass.

[0040]The wall 96 is set up and formed in the upper part from the bottom plate 97, and the end of the elastic bellows member 94 is being fixed to the tip part of the wall 96 so that the upper opening end of the exhaust port 89 may be surrounded. Furthermore, the other end of the bellows member 94 is joined to the holddown member 95 allocated in the prescribed position of the 2nd introducing pipe 93. In this way, when going up / dropping the treatment cup unit 49 using the rise-and-fall drive mechanism 50, the exhaust route in which it results to the exhaust port 89 is secured from the inlet port 91 because the bellows member 94 expands and contracts. The exhaust port 89 is connected with the drain 88b in the position of the point which is not illustrated, leads to a mist trap further, and it is constituted so that a fluid and a gas can be separated.

[0041]As shown in drawing 3, when the hand of cut of the substrate G is a direction shown by arrow S_1 , an air current arises in the same direction as arrow S_1 in the treatment cup unit 49. In this way, the 1st introducing pipe 92 is allocated so that the periphery of the outer cup 48 may be met, so that it may be inhaled from the inlet port 91 in a forward direction, as the air current to produce shows by arrow S_2 . By forming such an exhaust route, suction efficiency is raised and it becomes possible to catch effectively the mist generated further.

[0042]Now, as shown in drawing 3, the nozzle arm 51 for developing solutions is formed in one outer cup 48 side, and the developing solution regurgitation nozzle 80 is stored in the nozzle arm 51. The nozzle arm 51 is constituted so that the substrate G may be crossed with the drive mechanisms 52, such as belt driving, and it may move along with the guide rail 53, and by this at

the time of spreading of a developing solution. The nozzle arm 51 scans the stationary substrate G, breathing out a developing solution from a developing solution regurgitation nozzle. The developing solution regurgitation nozzle 80 stands by to the nozzle standby part 115, and the nozzle soaping-machine style 120 which washes the developing solution regurgitation nozzle 80 is formed in this nozzle standby part 115.

[0043]As the developing solution regurgitation nozzle 80, as shown in drawing 4 (a), it has the slit shape developing solution delivery 85, and that by which a developing solution is breathed out by band-like from the developing solution delivery 85 is used suitably. In making the nozzle arm 51 holding the developing solution regurgitation nozzle 80 scan along with the guide rail 53, Also when scanning from which direction, a developing solution is turned to the substrate G, and the developing solution delivery 85 is constituted so that the regurgitation of the developing solution can be vertically carried out to the substrate G, so that the regurgitation can be carried out.

[0044]As shown in drawing 4 (b), the nozzle arm 51 is constituted so that the plurality 80a and 80b, for example, two developing solution regurgitation nozzles, can be held, and by this, For example, also when the resist of a kind which is different with the substrate G of a certain lot and the substrate G of another lot is used, Since a different developing solution corresponding to the resist used from each of the developing solution regurgitation nozzles 80a and 80b can be made to breathe out, as compared with the case where the one developing solution regurgitation nozzle 80 is used. Without cleaning of the developing solution regurgitation nozzle 80 taking time, a development can be performed continuously and there is an advantage -- processing efficiency is raised.

[0045]The developing solution regurgitation nozzles 80a and 80b can change a height position according to the rising and falling mechanisms 58a and 58b, respectively, the developing solution regurgitation nozzle 80a, for example, a developing solution regurgitation nozzle, expands the rising and falling mechanism 58a, and while using it locates it caudad. When applying a predetermined developing solution on the substrate G by this from the developing solution delivery 85a of the developing solution regurgitation nozzle 80a, making the substrate G top scan the nozzle arm 51, In order that the developing solution delivery 85b of the developing solution regurgitation nozzle 80b which is not used may not touch the developing solution applied to the substrate G, mixing of a developing solution is prevented.

[0046]In the example of drawing 4 (b), although the developing solution regurgitation nozzle 80 of the two same structures was allocated in the nozzle arm 51, it is also possible to allocate another developing solution regurgitation nozzle from which shape differs, and the nozzle for the regurgitation of another treating solutions other than a developing solution may be allocated further.

[0047]The nozzle arm 54 for rinses, such as pure water, is formed in the another side side of the outer cup 48, and the rinse regurgitation nozzle 60 is formed in the tip end part of the nozzle arm 54. The nozzle arm 54 is formed by the drive mechanism 56 focusing on the pivot 55, enabling free rotation. Thereby, at the time of the regurgitation of a rinse, the nozzle arm 54 scans the substrate G top, breathing out a rinse from the rinse regurgitation nozzle 60.

[0048]The pure downflow supplied to the place where the upper part of the outer cup 48 serves as space, for example, a resist application and the processing equipment 100 are arranged is directly supplied to the development units (DEV) 24a-24c. As shown in drawing 5, the rotary drive 42 made to rotate the spin chuck 41, the drive mechanism 52 which drives the nozzle arm 51 for developing solutions and the drive mechanism 56 made to rotate the nozzle arm 54 for rinses, and the rise-and-fall drive mechanism 50 which performs rise and fall of the treatment cup unit 49, All are controlled by the control device 70.

[0049]Next, the developing processing stage in the development units (DEV) 24a-24c is explained. Drawing 6 is an explanatory view (flow chart) showing a developing processing stage, and drawing 7 is an explanatory view showing a state when the height position of the treatment cup unit 49 was changed with advance of a development in the developing processing stage.

[0050]First, the treatment cup unit 49 is held in a lower-berth position (Step 1). The lower-berth position of the treatment cup unit 49 is a position of outer cup 48 condition of use shown in drawing 7 (c) in drawing 7, and this state is also a position of the treatment cup unit 49 at the

time of a development being completed. In this way, as a state which has the treatment cup unit 49 in a lower-berth position, the transportation arm 19a holding the substrate G is inserted into the development unit (DEV) 24a – 24c, The spin chuck 41 is raised according to this timing, and the substrate G is delivered to the spin chuck 41 (Step 2).

[0051]The transportation arm 19a is made to shunt out of the development unit (DEV) 24a – 24c, The substrate G is supported so that the spin chuck 41 in which the substrate G was laid may be dropped, and it may hold to a prescribed position, and the attitude control pin 57 is raised, the bending produced in the substrate G may be small and the substrate G may be held at the abbreviated level (Step 3). Subsequently, the nozzle arm 51 is moved on the substrate G, a predetermined developing solution is applied on the substrate G from the developing solution regurgitation nozzle 80, scanning the substrate G top, and a developing solution paddle is formed (Step 4).

[0052]By the time predetermined development time (development reaction time) passes, while making the nozzle arm 51 shunt on the substrate G (on the treatment cup unit 49) after a developing solution paddle is formed, the treatment cup unit 49 is raised and it holds in an upper row position (Step 5). The upper row position of the treatment cup unit 49 is shown in drawing 7 (a), and the horizontal position of the surface of the substrate G makes it the height which suits the position of the taper part of the inner cup 46 mostly. When the bellows member 94 expands and contracts the treatment cup unit 49 in the case of a rise/descent, the exhaust route of the exhaustor style 90 is secured. When the treatment cup unit 49 is in an upper row position, it is in the state where the bellows member 94 developed.

[0053]After development reaction time, the attitude control pin 57 is dropped and it is isolated from the substrate G (Step 6). Thereby, rotation of the substrate G is attained. And almost as soon as it starts the operation which rotates the substrate G at a low speed, and shakes off the developing solution on the substrate G, a rinse is breathed out from the rinse regurgitation nozzle 60, the exhaustor style 90 is operated and, almost more nearly simultaneously still with these operations, side exhaust air is started (Step 7). That is, as for the exhaustor style 90, before the development reaction passage of time, it is preferred to change into the state where it does not operate, and, thereby, adverse effects, such as an air flow generation by operation of the exhaustor style 90, do not occur in the developing solution paddle formed on the substrate G.

[0054]Rotation of the substrate G is started, and the developing solution and a little rinses which disperse towards the periphery from the substrate G hit the taper part and peripheral wall of the inner cup 46, are led below, and are discharged from the drain 88a. Since a treating solution with high developing solution concentration which mainly consists of developing solutions is discharged from the drain 88a until predetermined time passes since the rotation start of the substrate G at this time, such effluent liquor operates and collects the cross valves provided in the drain 88a, and presents reproduction and reuse with them. On the other hand, since developing solution concentration falls after going through predetermined time, the effluent liquor with such low developing solution concentration operates the cross valve provided in the drain 88a, separates from a treating solution with high developing solution concentration, and collects.

[0055]After specified time elapse, the treatment cup unit 49 is dropped in the state where the substrate G has been rotated, from the rotation start of the substrate G, and it holds in a middle position (Step 8). The middle position of the treatment cup unit 49 is shown in drawing 7 (b), and the horizontal position of the surface of the substrate G makes it the height which suits the position of the taper part of the inside cup 47 mostly. From the rotation start of the substrate G, after specified time elapse, the treating solution which disperses from the substrate G mainly consists of rinses, and the concentration of a developing solution is falling. Such effluent liquor is discharged from the drain 88b. The number of rotations of the substrate G is made larger than the time of the rotating operation start for shaking off a developing solution so that the residue of a developing solution may decrease. Although it becomes easy to generate mist by raising the number of rotations of the substrate G, the generated mist is collected by the exhaustor style 90 through the inlet port 91.

[0056]Next, the regurgitation of a rinse is stopped (Step 9), the rinse regurgitation nozzle 60 is

stored to a position, the treatment cup unit 49 is dropped after that, with the substrate G rotated, and it holds in a lower-berth position (Step 10). The lower-berth position of the treatment cup unit 49 is shown in drawing 7 (c), and the horizontal position of the surface of the substrate G makes it mostly the height of the taper part of the outer cup 48, and the height which suits the bottom, for example, the formation position of the inlet port 91, a little rather than a taper part. After the treatment cup unit 49 is held at a lower-berth position, the high velocity revolution of the substrate G is carried out, and spin drying is performed (Step 11).

[0057]When spin drying is performed in the state where treating solutions, such as a developing solution and a rinse, have adhered to the internal surface of the peripheral wall of the cup arranged like before so that the substrate G may be surrounded, The mist which the air current generated by the high velocity revolution of the substrate G made generate mist, and generated in this way from the treating solution adhering to the internal surface of the cup soared over the substrate G, and it became particle, adhered to the substrate G, and the quality of the product was reduced. The treating solution shaken off by the high velocity revolution had a quick speed, when it collided with the internal surface of a cup, it was easy to generate mist, and when the distance of a substrate and an internal surface was short, there was a problem of becoming easy to generate mist.

[0058]However, if an internal surface makes spin drying surround with the outer cup 48 in the state (the state of a grade where it is thoroughly dry or the surface has got wet slightly is said) where it abbreviated-dried and performs it like this invention, The air current generated by carrying out the high velocity revolution of the substrate G does not almost generate mist from the internal surface of the outer cup 48. Since distance with the internal surface of the peripheral wall of the cup (outer cup 48) which catches the treating solution which disperses from the substrate G and the substrate G becomes long as the number of rotations of the substrate G becomes high-speed on the structure of the treatment cup unit 49, Generating of mist is prevented also by the generated air current being able to weaken and reaching an internal surface. At the time of spin drying, generating of mist is prevented also from speed being reduced, and the treating solution in which the distance of a substrate and the internal surface of the peripheral wall of the outer cup 48 disperses from a long time to a substrate colliding with an internal surface, or being directly introduced into the inlet port 91.

[0059]Generating of mist is prevented also from the strong air current generated around the substrate G hitting directly neither the inner cup 46 in which the developing solution and the rinse adhered to the internal surface, nor the inside cup 47 further again. In this way, the mist quantity generated at the time of spin drying is reduced notably, and it is controlled that mist adheres to the substrate G as particle. In addition, since mist is recovered by the side exhaust air by the exhaustor style 90, adhesion of particle in the substrate G is controlled.

[0060]Independently, although each has an effect in reduction of mist, or the adhesion control to the substrate G of particle, using the outer cup 48 which has the internal surface dry at the time of spin drying treatment, and performing side exhaust air using the exhaustor style 90, The effect can be further heightened by using both together.

[0061]After spin drying is completed, rotation of the substrate G is suspended (Step 12), the spin chuck 41 is raised (Step 13), the transportation arm 19a is inserted into the development unit (DEV) 24a - 24c according to the timing, and the substrate G is delivered (Step 14). While resulting in the delivery to the transportation arm 19a of the substrate G from after the end of rotation of the substrate G, operation of the exhaustor style 90 is suspended and it prepares for next processing.

[0062]In the state where Step 14 is completed and there is no substrate G in the spin chuck 41, since the treatment cup unit 49 is in a lower-berth position, the state of Step 1 will be satisfied. If the substrate G which should be processed next is conveyed in the development unit (DEV) 24a - 24c by the transportation arm 19a, it can carry out by continuing the development of the substrate G according to the process mentioned above after Step 2. In ending a development after Step 14, after taking out the substrate G out of the development unit (DEV) 24a - 24c, the spin chuck 41 is dropped and it stores the spin chuck 41 in the treatment cup unit 49.

[0063]As mentioned above, although the embodiment of the invention has been described, it

cannot be overemphasized that this invention is not what is limited to the above-mentioned gestalt. For example, as a means to hold the substrate G, it is not limited to the spin chuck 41 which holds the substrate G by adsorption power like the above-mentioned embodiment, For example, so that the position of the substrate G may not shift, when laying a substrate on two or more lock-pins formed in the bigger spin plate up than a substrate at the convex and rotating a substrate, The mechanical method of holding the substrate G by another pin etc. in the prescribed position of the end face of the substrate G, for example, four corners, can also be used.

[0064]Although you made it go up and down the treatment cup unit 49, the developing solution shook off in the developing processing stage and positioning at the time of rinsing treatment and spin drying was performed, a developing solution shakes off making it go up and down the spin chuck 41 by considering the treatment cup unit 49 as immobilization, and holding to a prescribed position -- etc. -- processing is also possible.

[0065]Although the above-mentioned embodiment explained the case where the liquid treatment devices of this invention were applied to the development unit in the resist application and development processing system of an LCD substrate to the example, this invention is not restricted to a development unit and can be applied to other liquid treatment devices. For example, the liquid treatment devices of this invention are applicable to the washing handling units (SCR) 21a and 21b and the resist coating treatment unit (CT) 22 in a resist application and a development processing system. Although the LCD substrate has been explained as a processed board, it is possible to use about other substrates, such as a semiconductor wafer and CD board.

[0066]

[Effect of the Invention]According to the liquid treatment devices and the liquid treating method of this invention as the above explanation. Since it is exhausted by the exhauster style provided in the peripheral wall of the cup even if the mist of a treating solution occurs during liquid treatment, it becomes possible to prevent dance going up in the substrate sky of mist, and to prevent adhesion of particle in a substrate. From attracting the air current produced by rotation of a substrate in a forward direction, an exhauster style can be exhausted efficiently.

[0067]At the time of spin drying, since the periphery of the substrate is surrounded from the cup in the state where the internal surface dried mostly, it does not say that mist is generated from the treating solution in which the air current generated when the high velocity revolution of the substrate is carried out has adhered to the internal surface, and, thereby, generating of mist is prevented. Since distance with the internal surface of the cup which catches the treating solution which disperses from a substrate and a substrate becomes long as the number of rotations of the substrate G becomes high-speed, generating of mist is prevented also by the generated air current being able to weaken and reaching an internal surface. Generating of mist is prevented also from the strong air current generated around a substrate at the time of spin rotation of a substrate hitting directly neither the inner cup in which the developing solution and the rinse adhered to the internal surface, nor an inside cup further again.

[0068]Thus, according to this invention, since mist is efficiently exhausted even if it is, when generating of the mist at the time of liquid treatment is prevented and mist occurs, the mist quantity which soars to the sky of a substrate is reduced, and the coating weight of the particle to a substrate is reduced. In this way, it becomes possible to obtain the substrate of high quality with little coating weight of particle, the yield improves by reduction of a product defect, and the prominent effect that high reliability is secured is acquired.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1]The top view showing one embodiment of the resist application and developing system with which the liquid treatment devices of this invention are used.

[Drawing 2]The sectional view showing one embodiment of the development unit concerning the liquid treatment devices of this invention.

[Drawing 3]The top view showing one embodiment of the development unit concerning the liquid treatment devices of this invention.

[Drawing 4]The perspective view showing one embodiment of a developing solution regurgitation nozzle used for the development unit concerning the liquid treatment devices of this invention.

[Drawing 5]The explanatory view showing one embodiment of the control system of the development unit concerning the liquid treatment devices of this invention.

[Drawing 6]The explanatory view showing an example of the developing processing stage which is one embodiment of the liquid treating method of this invention.

[Drawing 7]The explanatory view showing the movement formations of the position of the treatment cup unit in the developing processing stage using the development unit concerning the liquid treatment devices of this invention.

[Description of Notations]

1; cassette station

2; treating part

3; interface part

24a-24c; development unit (DEV)

41; spin chuck

46; inner cup

47; Inside cup

48; outer cup

49; treatment cup unit

50; rise-and-fall drive mechanism

57; attitude control pin

89; exhaust port

90; exhauster style

91; inlet port

92; the 1st introducing pipe

93; the 2nd introducing pipe

94; bellows member

95; holddown member

96; wall

97; bottom plate

100; a resist application and a development processing system

G; substrate (processed board)

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-59067

(P2002-59067A)

(43) 公開日 平成14年2月26日 (2002.2.26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコート* (参考)
B 0 5 C 11/08		B 0 5 C 11/08	2 H 0 8 8
B 0 5 D 1/40		B 0 5 D 1/40	A 4 D 0 7 5
G 0 2 F 1/13	1 0 1	G 0 2 F 1/13	1 0 1 4 F 0 4 2

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2000-245645(P2000-245645)

(22) 出願日 平成12年8月14日 (2000.8.14)

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72) 発明者 宮崎 一仁

熊本県菊池郡大津町大字高尾野字平成272

番地の4 東京エレクトロン九州株式会社
大津事業所内

(72) 発明者 八尋 俊一

熊本県菊池郡大津町大字高尾野字平成272

番地の4 東京エレクトロン九州株式会社
大津事業所内

(74) 代理人 100099944

弁理士 高山 宏志

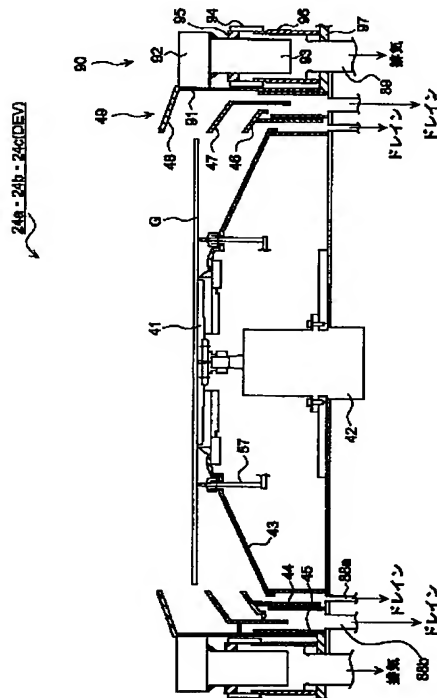
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液処理装置および液処理方法

(57) 【要約】

【課題】 スピナ型の液処理装置におけるミストの発生を低減し、パーティクルの付着量の少ない高品質な基板の提供を可能ならしめる液処理装置および液処理方法を提供する。

【解決手段】 液処理装置は、基板Gを載置して保持する保持手段（スピンチャック）41と、基板Gに所定の処理液を供給する処理液供給機構と、スピンチャック41とともに基板Gが面内回転するように回転させる回転駆動機構42と、基板Gのスピン乾燥処理の当初に内壁面が略乾燥した状態にあり、スピン乾燥処理時に基板Gを囲繞するように配置されて用いられる外カップ48を有する処理カップユニット49と、処理カップユニット49の昇降機構50とを具備する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板を載置して保持する保持手段と、
前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、
前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、
前記保持手段に保持された基板を囲繞するように配設されたカップと、
前記カップの外周壁に配設された排気機構と、
を具備することを特徴とする液処理装置。

【請求項 2】 基板を載置して保持する保持手段と、
前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、
前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、
前記保持手段に保持された基板を囲繞するように配設された処理カップユニットと、
前記処理カップユニットを昇降させる昇降機構とを具備し、
前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給した後に基板を回転させてスピン乾燥を行う液処理装置であって、
前記処理カップユニットは、
液処理の際には略乾燥状態に維持される位置に配置され、かつ、前記スピン乾燥の際には前記保持手段に保持された基板を囲繞する位置に配置されるカップを有することを特徴とする液処理装置。

【請求項 3】 前記カップの外周壁に排気機構が配設されていることを特徴とする請求項 2 に記載の液処理装置。

【請求項 4】 前記基板の回転によって生ずる気流が順方向で吸気されるように、前記排気機構において排気経路が形成されていることを特徴とする請求項 1 または請求項 3 に記載の液処理装置。

【請求項 5】 基板を載置して保持する保持手段と、
前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、
前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、
前記基板を囲繞するように配設され、かつ、内側から外側に向かって逐次高さが高くなるように形成された内カップ、中カップ、外カップからなる 3 重構造の処理カップユニットと、
前記処理カップユニットの昇降機構と、
を具備することを特徴とする液処理装置。

【請求項 6】 基板を載置して保持する保持手段と、
前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、
前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、

前記基板を囲繞するように配設され、かつ、内側から外側に向かって逐次高さが高くなるように形成された内カップ、中カップ、外カップからなる 3 重構造の処理カップユニットと、

前記処理カップユニットの昇降機構と、
前記外カップの外周壁に設けられた排気機構と、
を具備することを特徴とする液処理装置。

【請求項 7】 前記基板の回転によって生ずる気流が順方向で吸気されるように、前記排気機構の排気経路が形成されていることを特徴とする請求項 6 に記載の液処理装置。

【請求項 8】 前記処理カップユニットは、前記内カップ、前記中カップ、前記外カップが一体的に形成されることを特徴とする請求項 5 から請求項 7 のいずれか 1 項に記載の液処理装置。

【請求項 9】 前記外カップは、前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給した後に基板を回転させてスピン乾燥を行う際に、基板から飛散する処理液を回収するために、基板を囲繞する位置に配置されることを特徴とする請求項 5 から請求項 8 のいずれか 1 項に記載の液処理装置。

【請求項 10】 略水平に保持された基板を面内で回転させながら基板に所定の処理液を供給して行う液処理方法であって、
前記処理液の供給中に基板から飛散する処理液を回収するために使用されるカップと、
前記処理液の供給停止後に基板を回転させてスピン乾燥を行う際に基板から飛散する処理液を回収するために使用される内壁面が略乾燥した状態にあるカップと、
を使い分けることを特徴とする液処理方法。

【請求項 11】 前記スピン乾燥時に使用されるカップの外周壁に排気機構を設け、前記排気機構を動作させて前記処理カップユニット内からの排気を行いながら前記スピン乾燥を行うことを特徴とする請求項 10 に記載の液処理方法。

【請求項 12】 略水平に保持された基板を面内で回転させながら前記基板に所定の処理液を供給して行う液処理方法であって、
内側から外側に向かって逐次高さが高くなるように形成された内カップ、中カップ、外カップからなる 3 重構造の処理カップユニットを基板を囲繞するように配設し、
前記基板の回転開始から所定時間を経過するまでに回転する基板から飛散する処理液を前記内カップで回収する第 1 回収工程と、
前記第 1 回収工程後、前記処理液の供給停止までの間に回転する基板から飛散する処理液を前記中カップで回収する第 2 回収工程と、
前記処理液の供給を停止した後に基板を回転させてスピン乾燥を行う際に基板から飛散する処理液を前記外カップで回収する第 3 回収工程と、

10

20

30

40

50

を有することを特徴とする液処理方法。

【請求項13】 前記外カップの外周壁に排気機構を配設し、前記排気機構を動作させて前記処理カップユニット内からの排気を行いながら前記第3回収工程を行うことを特徴とする請求項12に記載の液処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば液晶ディスプレイ（LCD）用ガラス基板や半導体ウエハ等の基板に所定の液処理を施すスピナ型の液処理装置と液処理方法に関する。

【0002】

【従来の技術】例えば、液晶表示ディスプレイ（LCD）や半導体デバイスのフォトリソグラフィ工程においては、一般的にスピナ型と呼ばれる液処理装置を用いて、LCD基板や半導体ウエハ等の基板を面内でスピン回転させ、洗浄、レジスト塗布、現像等の処理が行われている。

【0003】例えば、LCD基板の現像処理においては、露光処理された基板をスピンチャック等に載置、固定して現像液を基板上に液盛りし、パドルを形成して現像反応を進行させ、所定時間経過した後に基板を回転させると同時にリンス液の供給を開始して現像液とリンス液を振り切り、その後リンス液の供給を停止して基板を高速で回転させるスピン乾燥が行われている。このように、スピナ型の液処理装置においては、基板を回転させて基板から処理液を四方へ飛散させることで、処理液が振り切られる。

【0004】このようにして、基板から振り切られた処理液は、基板を囲繞するように設けられた処理カップユニットの内壁面に衝突して下方へ導かれ、ドレインを通じて回収され、または廃棄されていた。また、処理カップユニットとしては、基板を低速で回転させる際に基板を囲繞するように配置される内側カップと、基板を高速で回転させるスピン乾燥を行う際に基板を囲繞するように配置される外側カップと、からなる二重構造を有するものが主に用いられていた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の二重構造の処理カップユニットを用いた場合には、基板から振り切られた処理液が内側カップと外側カップの両内壁面に付着しており、内側カップまたは外側カップに囲繞された状態で基板を乾燥のために高速で回転させると、回転により発生した気流が内側カップまたは外側カップの内壁面に付着した処理液からミストを発生させ、このミストが基板上へ舞い上がって基板にパーティクルとなって付着し、基板の品質を低下させる問題があった。

【0006】本発明はかかる従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、スピナ型の液処理装置にお

けるミストの発生を低減し、パーティクルの付着量の少ない高品質な基板の提供を可能ならしめる液処理装置および液処理方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、第1発明として、基板を載置して保持する保持手段と、前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、前記保持手段に保持された基板を囲繞するように配設されたカップと、前記カップの外周壁に配設された排気機構と、を具備することを特徴とする液処理装置、を提供する。

【0008】本発明は第2発明として、基板を載置して保持する保持手段と、前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、前記保持手段に保持された基板を囲繞するように配設された処理カップユニットと、前記処理カップユニットを昇降させる昇降機構とを具備し、前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給した後に基板を回転させてスピン乾燥を行う液処理装置であって、前記処理カップユニットは、液処理の際には略乾燥状態に維持される位置に配置され、かつ、前記スピン乾燥の際には前記保持手段に保持された基板を囲繞する位置に配置されるカップを有することを特徴とする液処理装置、を提供する。

【0009】本発明は第3発明として、基板を載置して保持する保持手段と、前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、前記基板を囲繞するように配設され、かつ、内側から外側に向かって逐次高さが高くなるように形成された内カップ、中カップ、外カップからなる3重構造の処理カップユニットと、前記処理カップユニットの昇降機構と、を具備することを特徴とする液処理装置、を提供する。

【0010】本発明は第4発明として、基板を載置して保持する保持手段と、前記保持手段に保持された基板に所定の処理液を供給する処理液供給機構と、前記保持手段とともに基板が面内回転するように基板を回転させる回転手段と、前記基板を囲繞するように配設され、かつ、内側から外側に向かって逐次高さが高くなるように形成された内カップ、中カップ、外カップからなる3重構造の処理カップユニットと、前記処理カップユニットの昇降機構と、前記外カップの外周壁に設けられた排気機構と、を具備することを特徴とする液処理装置、を提供する。

【0011】本発明は第5発明として、略水平に保持された基板を面内で回転させながら基板に所定の処理液を

供給して行う液処理方法であって、前記処理液の供給中に基板から飛散する処理液を回収するために使用されるカップと、前記処理液の供給停止後に基板を回転させてスピン乾燥を行う際に基板から飛散する処理液を回収するために使用される内壁面が略乾燥した状態にあるカップと、を使い分けることを特徴とする液処理方法、を提供する。

【0012】本発明は第6発明として、略水平に保持された基板を面内で回転させながら前記基板に所定の処理液を供給して行う液処理方法であって、内側から外側に向かって逐次高さが高くなるように形成された内カップ、中カップ、外カップからなる3重構造の処理カップユニットを基板を圍繞するように配設し、前記基板の回転開始から所定時間を経過するまでに回転する基板から飛散する処理液を前記内カップで回収する第1回収工程と、前記第1回収工程後、前記処理液の供給停止までの間に回転する基板から飛散する処理液を前記中カップで回収する第2回収工程と、前記処理液の供給を停止した後に基板を回転させてスピン乾燥を行う際に基板から飛散する処理液を前記外カップで回収する第3回収工程と、を有することを特徴とする液処理方法、を提供する。

【0013】このような液処理装置および液処理方法によれば、液処理中に処理液のミストが発生しても、カップの外周壁に設けられた排気機構によって排気されることから、ミストの基板上空への舞い上がりが防止され、基板へのパーティクルの付着を防止することが可能となる。また、スピン乾燥時に内壁面が略乾燥状態にあるカップ、例えば、3重構造となっている場合の外カップで基板を圍繞することにより、ミストの発生が防止され、基板の上空へ舞い上がるミスト量を低減することも可能となる。この場合に、さらにカップの外周壁からの排気を行うと、より効果的にミストを排気することができ、このようにしてパーティクルの付着の少ない高い品質の基板を得ることにより、製品不良が低減され、信頼性が高められる。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。図1は、本発明の液処理装置の一実施形態である現像処理ユニット(DEV)24a~24cを有するLCD基板のレジスト塗布・現像処理システム100を示す平面図である。

【0015】レジスト塗布・現像処理システム100は、複数のLCD基板(基板)Gを収容するカセットCを載置するカセットステーション1と、基板Gにレジスト塗布および現像を含む一連の処理を施すための複数の処理ユニットを備えた処理部2と、露光装置(図示せず)との間で基板Gの受け渡しを行うためのインターフェイス部3とを備えており、処理部2の両端にそれぞれカセットステーション1およびインターフェイス部3が

配置されている。

【0016】カセットステーション1は、カセットCと処理部2との間で基板Gの搬送を行うための搬送機構10を備えている。そして、カセットステーション1においてカセットCの搬入出が行われる。また、搬送機構10はカセットの配列方向に沿って設けられた搬送路10a上を移動可能な搬送アーム11を備え、この搬送アーム11によりカセットCと処理部2との間で基板Gの搬送が行われる。

【0017】処理部2は、前段部2aと中段部2bと後段部2cとに分かれており、それぞれ中央に搬送路12・13・14を有し、これら搬送路の両側に各処理ユニットが配設されている。そして、これらの間には中継部15・16が設けられている。

【0018】前段部2aは、搬送路12に沿って移動可能な主搬送装置17を備えており、搬送路12の一方側には、2つの洗浄ユニット(SCR)21a・21bが配置されており、搬送路12の他方側には紫外線照射ユニット(UV)と冷却ユニット(COL)とが2段に重ねられた処理ブロック25、加熱処理ユニット(HP)が2段に重ねられてなる処理ブロック26および冷却ユニット(COL)が2段に重ねられてなる処理ブロック27が配置されている。

【0019】また、中段部2bは、搬送路13に沿って移動可能な主搬送装置18を備えており、搬送路13の一方側には、レジスト塗布処理ユニット(CT)22および基板Gの周縁部のレジストを除去する周縁レジスト除去ユニット(ER)23が一体的に設けられており、搬送路13の他方側には、加熱処理ユニット(HP)が2段に重ねられてなる処理ブロック28、加熱処理ユニット(HP)と冷却処理ユニット(COL)が上下に重ねられてなる処理ブロック29、およびアドヒージョン処理ユニット(AD)と冷却ユニット(COL)とが上下に重ねられてなる処理ブロック30が配置されている。

【0020】さらに、後段部2cは、搬送路14に沿って移動可能な主搬送装置19を備えており、搬送路14の一方側には、3つの現像処理ユニット(DEV)24a・24b・24cが配置されており、搬送路14の他方側には加熱処理ユニット(HP)が2段に重ねられてなる処理ブロック31、およびともに加熱処理ユニット(HP)と冷却処理ユニット(COL)が上下に重ねられてなる処理ブロック32・33が配置されている。

【0021】なお、処理部2は、搬送路を挟んで一方の側に洗浄ユニット(SCR)21a、レジスト塗布処理ユニット(CT)22、現像処理ユニット(DEV)24aのようなスピンナ系ユニットのみを配置しており、他方の側に加熱処理ユニット(HP)や冷却処理ユニット(COL)等の熱系処理ユニットのみを配置する構造となっている。

【0022】また、中継部15・16のスピナ系ユニット配置側の部分には、薬液供給ユニット34が配置されており、さらに主搬送装置17・18・19のメンテナンスを行うためのスペース35が設けられている。

【0023】主搬送装置17・18・19は、それぞれ水平面内の2方向のX軸駆動機構、Y軸駆動機構、および垂直方向のZ軸駆動機構を備えており、さらにZ軸を中心に回転する回転駆動機構を備えており、それぞれ基板Gを支持するアームを有している。

【0024】主搬送装置17は、搬送アーム17aを有し、搬送機構10の搬送アーム11との間で基板Gの受け渡しを行うとともに、前段部2aの各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、さらには中継部15との間で基板Gの受け渡しを行う機能を有している。また、主搬送装置18は搬送アーム18aを有し、中継部15との間で基板Gの受け渡しを行うとともに、中段部2bの各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、さらには中継部16との間の基板Gの受け渡しを行う機能を有している。さらに、主搬送装置19は搬送アーム19aを有し、中継部16との間で基板Gの受け渡しを行うとともに、後段部2cの各処理ユニットに対する基板Gの搬入・搬出、さらにはインターフェイス部3との間の基板Gの受け渡しを行う機能を有している。なお、中継部15・16は冷却プレートとしても機能する。

【0025】インターフェイス部3は、処理部2との間で基板Gを受け渡しする際に一時的に基板Gを保持するエクステンション36と、さらにその両側に設けられた、バッファカセットを配置する2つのバッファステージ37と、これらと露光装置（図示せず）との間の基板Gの搬入出を行う搬送機構38とを備えている。搬送機構38はエクステンション36およびバッファステージ37の配列方向に沿って設けられた搬送路38a上を移動可能な搬送アーム39を備え、この搬送アーム39により処理部2と露光装置との間で基板Gの搬送が行われる。

【0026】このように各処理ユニットを集約して一体化することにより、省スペース化および処理の効率化を図ることができる。

【0027】このように構成されたレジスト塗布・現像処理システム100においては、カセットC内の基板Gが処理部2に搬送され、処理部2では、まず前段部2aの処理ブロック25の紫外線照射ユニット（UV）で表面改質・洗浄処理が行われ、冷却処理ユニット（COL）で冷却された後、洗浄ユニット（SCR）21a・21bでスクラバ洗浄が施され、処理ブロック26のいずれかの加熱処理ユニット（HP）で加熱乾燥された後、処理ブロック27のいずれかの冷却ユニット（COL）で冷却される。

【0028】その後、基板Gは中段部2bに搬送され、レジストの定着性を高めるために、処理ブロック30の

上段のアドヒージョン処理ユニット（AD）にて疎水化処理（HMDS処理）され、下段の冷却処理ユニット（COL）で冷却後、レジスト塗布処理ユニット（CT）22でレジストが塗布され、周縁レジスト除去ユニット（ER）23で基板Gの周縁の余分なレジストが除去される。その後、基板Gは、中段部2bの中の加熱処理ユニット（HP）の1つでブリベーク処理され、処理ブロック29または30の下段の冷却ユニット（COL）で冷却される。

【0029】その後、基板Gは中継部16から主搬送装置19にてインターフェイス部3を介して露光装置に搬送されてそこで所定のパターンが露光される。そして、基板Gは再びインターフェイス部3を介して搬入され、必要に応じて後段部2cの処理ブロック31・32・33のいずれかの加熱処理ユニット（HP）でポストエクスポージャーベーク処理を施した後、現像処理ユニット（DEV）24a・24b・24cのいずれかで現像処理され、所定の回路パターンが形成される。現像処理された基板Gは、後段部2cのいずれかの加熱処理ユニット（HP）にてポストベーク処理が施された後、いずれかの冷却ユニット（COL）にて冷却され、主搬送装置19・18・17および搬送機構10によってカセットステーション1上の所定のカセットに収容される。

【0030】次に、本発明に係る現像処理ユニット（DEV）24a～24cについて詳細に説明する。図2は現像処理ユニット（DEV）の断面図であり、図3は現像処理ユニット（DEV）24a～24cの平面図である。図3に示されるように、現像処理ユニット（DEV）24a～24cを構成する各種部材はシンク59内に配設されている。

【0031】図2に示すように、現像処理ユニット（DEV）24a～24cにおいては、基板Gを機械的に保持する保持手段、例えば、スピンチャック41がモータ等の回転駆動機構42により回転されるように設けられ、このスピンチャック41の下側には、回転駆動機構42を包囲するカバー43が配置されている。スピンチャック41は図示しない昇降機構により昇降可能となっており、上昇位置において搬送アーム19aとの間で基板Gの受け渡しを行う。スピンチャック41は真空吸引力等により、基板Gを吸着保持できるようになっている。

【0032】カバー43の一部を貫通するように基板Gの姿勢制御ピン57が複数配設されている。基板Gの外周部は自重によって撓み易く、その結果、表面が曲面となった場合には現像液バドルの形成が困難となるため、姿勢制御ピン57の高さを調節して、基板Gの下側から基板Gの表面が略水平となるように、基板Gを支持して姿勢制御を行う。このため、姿勢制御ピン57は図示しない昇降機構に連結されている。なお、姿勢制御ピン57が基板Gを支持した状態では基板Gを回転させること

ができないため、基板Gをスピンチャック41とともに回転させる場合には、遅くとも回転開始までに姿勢制御ピン57を降下させて基板Gから離隔する。

【0033】なお、姿勢制御ピン57の位置を固定して、スピンチャック41の高さを調節することにより基板Gの撓みを解消する方法も考えられるが、その場合には、姿勢制御ピン57の固定高さに狂いが生じた場合の調節が容易ではないという問題が生ずる。また、基板G上に現像液パドルを形成した後に基板G上の現像液を振り切るために、基板Gが姿勢制御ピン57から離れるようにスピンチャック41を上昇させた場合には、現像液パドルの形態に部分的な差が生じて現像されたパターンに部分的な差異が生ずること等が危惧される。しかしながら、姿勢制御ピン57を昇降自在に構成すると、このような問題は生じない。

【0034】カバー43の外周には2つのアンダーカップ44・45が離間して設けられており、内側のアンダーカップ44の内周側上方には、基板Gから飛散する現像液およびリンス液と混合され濃度がわずかに低下した現像液をアンダーカップ44の内周側底部に形成されたドレイン88aに導くための内カップ（インナーカップ）46が設けられている。なお、ドレイン88aは図示しない三方弁に連通しており、基板Gからの現像液の振り切りとリンス液の供給のタイミングに合わせて三方弁を切り替えることにより、リンス液が殆ど混じっていない現像液とリンス液が混合されて濃度が薄くなった現像液とを、分離・回収できるようになっている。

【0035】また、2つのアンダーカップ44・45間の上方には、主に基板Gから飛散するリンス液をアンダーカップ44・45間の底部に設けられたドレイン88bへ導くための中カップ（ミドルカップ）47が設けられている。ドレイン88bは、内カップ46と中カップ47および後述する外カップ48からなる3重構造の処理カップユニット49内の排気にも用いられる。

【0036】外側のアンダーカップ45の外周側上方には、主にリンス液のミストをドレイン88bまたは後述する排気口89へ導くための外カップ（アウターカップ）48が配設されている。内カップ46・中カップ47・外カップ48は、それぞれが傾斜したテーパ部と略垂直に立設された外周壁（側面壁）を有しており、互いに連結されて3重構造を有する処理カップユニット49を構成している。このような処理カップユニット49の構成を示すために、図2右側では、回収する処理液が流れ落ちるための孔部を示すために内カップ46・中カップ47・外カップ48は別体で示されており、一方、図2左側では、内カップ46・中カップ47・外カップ48が一体的に構成されていることを示すためにその接合部分を示した形態が示されている。

【0037】さて、図3に示すように、外カップ48の外周には十字方向の4箇所に昇降駆動機構50が配設さ

れており、後述する制御装置70からの信号を受けて処理カップユニット49の昇降動作を行い、処理カップユニット49を所定の高さ位置に停止、保持することが可能となっている。こうして、内カップ46・中カップ47・外カップ48の高さ位置を調節して、現像処理のタイミングに合わせてドレイン88a・88bを使い分けることにより、前述したように、濃い現像液、リンス液が混じった薄い現像液、リンス液および少量の現像液が混じったリンス液を、別々に回収することができる。

【0038】また、図2、図3に示すように、外カップ48の外周壁には十字方向の4箇所に排気機構90が配設されている。この排気機構90は、主に外カップ48を用いて基板Gから飛散する処理液を回収する際に処理カップユニット49内から吸気を行うように動作させるが、内カップ46や中カップ47を用いて処理液の回収を行っている場合においても、吸気動作を行うことによりミストを含めた吸排気を行うことが可能である。

【0039】ここで、排気機構90の構成について説明する。外カップ48の外周壁には吸気口91が形成されており、吸気口91に連通して第1導入管92が配設され、第1導入管92に導入された気流を下方へ導くための第2導入管93が第1導入管92に連通して設けられ、さらに、第2導入管93の下方に排気口89が形成されている。こうして、排気機構90は外カップ48の外周壁を通しての側面排気を行う。

【0040】排気口89の上部開口端を囲繞するように、壁部96が底板97から上方に立設して設けられており、壁部96の先端部には伸縮自在な蛇腹部材94の一端が固定されている。さらに蛇腹部材94の他端は第2導入管93の所定位置に配設された固定部材95と接合されている。こうして、昇降駆動機構50を用いて処理カップユニット49を上昇／降下させる場合には、蛇腹部材94が伸縮することで吸気口91から排気口89へ至る排気経路が確保されるようになっている。排気口89はドレイン88bと図示しない先の位置で連結され、さらにミストトラップにつながり、液体と気体とを分離することができるように構成されている。

【0041】なお、図3に示すように、基板Gの回転方向が矢印S₁で示される方向である場合には、処理カップユニット49内においては矢印S₁と同じ方向に気流が生ずる。こうして生ずる気流が矢印S₂で示すように順方向で吸気口91から吸気されるように、第1導入管92は外カップ48の外周に沿うように配設されている。このような排気経路を形成することにより吸気効率が高められ、さらには発生したミストを効果的に捕集することが可能となる。

【0042】さて、図3に示すように、外カップ48の一方の側には、現像液用のノズルアーム51が設けられ、ノズルアーム51内には現像液吐出ノズル80が収納されている。ノズルアーム51は、ガイドレール53

に沿って、ベルト駆動等の駆動機構52により基板Gを横切って移動するように構成され、これにより、現像液の塗布時には、ノズルアーム51は、現像液吐出ノズルから現像液を吐出しながら、静止した基板Gをスキャンするようになっている。また、現像液吐出ノズル80は、ノズル待機部115に待機されるようになっており、このノズル待機部115には現像液吐出ノズル80を洗浄するノズル洗浄機構120が設けられている。

【0043】現像液吐出ノズル80としては、図4(a)に示すように、スリット状の現像液吐出口85を有し、現像液吐出口85から現像液が帯状に吐出されるものが好適に用いられる。現像液吐出ノズル80を保持したノズルアーム51をガイドレール53に沿ってスキャンさせる場合には、どちらの方向からスキャンする場合にも、現像液を基板Gに向けて吐出できるように、現像液吐出口85は、基板Gに対して垂直に現像液を吐出できるように構成されている。

【0044】ノズルアーム51は、図4(b)に示すように、複数、例えば2本の現像液吐出ノズル80a・80bを保持することができるよう構成されており、これにより、例えば、あるロットの基板Gと別のロットの基板Gとで異なる種類のレジストが使用されていた場合にも、現像液吐出ノズル80a・80bの各々から使用されたレジストに対応した異なる現像液を吐出させることができることから、1本の現像液吐出ノズル80を用いる場合と比較すると、現像液吐出ノズル80の清掃に時間を要することなく、現像処理を連続的に行うことができ、処理効率が高められる等の利点がある。

【0045】現像液吐出ノズル80a・80bは、それぞれ昇降機構58a・58bにより高さ位置を変えることができ、使用する一方の現像液吐出ノズル、例えば現像液吐出ノズル80aは昇降機構58aを伸張させて下方に位置させる。これにより、ノズルアーム51を基板G上をスキャンさせながら、現像液吐出ノズル80aの現像液吐出口85aから所定の現像液を基板G上に塗布する際には、使用しない現像液吐出ノズル80bの現像液吐出口85bは基板Gに塗布された現像液に触れることはないため、現像液の混合が防止される。

【0046】なお、図4(b)の例では、2本の同じ構造の現像液吐出ノズル80をノズルアーム51に配設したが、形状の異なる別の現像液吐出ノズルを配設することも可能であり、さらに現像液以外の別の処理液の吐出のためのノズルを配設しても構わない。

【0047】外カップ48の他方の側には、純水等のリンス液用のノズルアーム54が設けられ、ノズルアーム54の先端部分には、リンス液吐出ノズル60が設けられている。ノズルアーム54は、枢軸55を中心として駆動機構56により回転自在に設けられている。これにより、リンス液の吐出時には、ノズルアーム54は、リンス液吐出ノズル60からリンス液を吐出しながら基板

G上をスキャンするようになっている。

【0048】なお、外カップ48の上方は空間となっており、例えば、レジスト塗布・現像処理装置100が配置される場所に供給される清浄なダウンフローが直接に現像処理ユニット(DEV)24a~24cに供給されるようになっている。また、図5に示すように、スピチャック41を回転させる回転駆動機構42、現像液用のノズルアーム51を駆動する駆動機構52、およびリンス液用のノズルアーム54を回動させる駆動機構56、処理カップユニット49の昇降を行う昇降駆動機構50は、いずれも制御装置70により制御されるようになっている。

【0049】次に、現像処理ユニット(DEV)24a~24cにおける現像処理工程について説明する。図6は現像処理工程を示す説明図(フローチャート)であり、図7は現像処理工程において現像処理の進行にともなって処理カップユニット49の高さ位置を変えたときの状態を示した説明図である。

【0050】最初に、処理カップユニット49を下段位置に保持する(ステップ1)。処理カップユニット49の下段位置は図7においては図7(c)に示される外カップ48使用状態の位置であり、この状態は現像処理が終了した時点の処理カップユニット49の位置でもある。こうして処理カップユニット49が下段位置にある状態として、基板Gを保持した搬送アーム19aを現像処理ユニット(DEV)24a~24c内に挿入し、このタイミングに合わせてスピチャック41を上昇させて、基板Gをスピチャック41へ受け渡す(ステップ2)。

【0051】搬送アーム19aを現像処理ユニット(DEV)24a~24c外に待避させ、基板Gが載置されたスピチャック41を降下させて所定位置に保持し、姿勢制御ピン57を上昇させて、基板Gに生ずる撓みが小さく、かつ、基板Gが略水平に保持されるように、基板Gを支持する(ステップ3)。次いで、ノズルアーム51を基板G上に移動させ、基板G上をスキャンしながら現像液吐出ノズル80から所定の現像液を基板G上に塗布し、現像液バドルを形成する(ステップ4)。

【0052】現像液バドルが形成された後、所定の現像処理時間(現像反応時間)が経過するまでの間に、ノズルアーム51を基板G上(処理カップユニット49上)から待避させるとともに、処理カップユニット49を上昇させ、上段位置に保持する(ステップ5)。処理カップユニット49の上段位置は図7(a)に示されており、基板Gの表面の水平位置がほぼ内カップ46のテーパー部の位置に合う高さとする。処理カップユニット49を上昇/降下の際には、蛇腹部材94が伸縮することにより、排気機構90の排気経路が確保される。処理カップユニット49が上段位置にある場合には、蛇腹部材94が伸張した状態にある。

【0053】現像反応時間後には、姿勢制御ピン57を降下させ、基板Gから離隔する（ステップ6）。これにより基板Gの回転駆動が可能となる。そして、基板Gを低速で回転させて基板G上の現像液を振り切る動作に入るのとはほぼ同時に、リンス液をリンス液吐出ノズル60から吐出し、さらにこれらの動作とほぼ同時に、排気機構90を動作させて側面排気を開始する（ステップ7）。つまり、現像反応時間の経過前には排気機構90は未動作の状態とすることが好ましく、これにより、基板G上に形成された現像液パドルには、排気機構90の動作による気流発生等の悪影響が発生しない。

【0054】基板Gの回転が開始され、基板Gからその外周に向けて飛散する現像液および少量のリンス液は、内カップ46のテーバー部や外周壁に当たって下方へ導かれ、ドレイン88aから排出される。このとき、基板Gの回転開始から所定の時間が経過するまでは、主に現像液からなる現像液濃度の高い処理液がドレイン88aから排出されるために、このような排出液はドレイン88aに設けられた三方弁を操作して回収し、再生、再利用に供する。一方、所定時間を経過した後は現像液濃度が低下するので、このような現像液濃度の低い排出液は、ドレイン88aに設けられた三方弁を操作して、現像液濃度の高い処理液と分離して回収する。

【0055】基板Gの回転開始から所定時間経過後には、基板Gを回転させたままの状態では処理カップユニット49を降下させて中段位置に保持する（ステップ8）。処理カップユニット49の中段位置は図7（b）に示されており、基板Gの表面の水平位置がほぼ中カップ47のテーバー部の位置に合う高さとする。基板Gの回転開始から所定時間経過後には、基板Gから飛散する処理液は主にリンス液からなり、現像液の濃度は低下している。このような排出液はドレイン88bから排出される。さらに、現像液の残渣が少なくなるように、基板Gの回転数を現像液を振り切るための回転動作開始時よりも大きくする。なお、基板Gの回転数を上げることによりミストが発生し易くなるが、発生したミストは排気機構90により吸気口91を通して回収される。

【0056】次に、リンス液の吐出を停止して（ステップ9）、リンス液吐出ノズル60を所定の位置に収納し、その後に、基板Gを回転させたまま処理カップユニット49を降下させて下段位置に保持する（ステップ10）。処理カップユニット49の下段位置は図7（c）に示されており、基板Gの表面の水平位置がほぼ外カップ48のテーバー部の高さやテーバー部よりも若干下側、例えば、吸気口91の形成位置に合う高さとする。処理カップユニット49が下段位置に保持された後には、基板Gを高速回転させてスピン乾燥を行う（ステップ11）。

【0057】従来のように、基板Gを囲繞するように配置されたカップの外周壁の内壁面に現像液やリンス液等

の処理液が付着したままの状態ではスピン乾燥を行った場合には、基板Gの高速回転によって発生した気流がカップの内壁面に付着した処理液からミストを発生させ、こうして発生したミストが基板Gの上空に舞い上がり、基板Gにパーティクルとなって付着して製品の品質を低下させていた。また高速回転により振り切られた処理液は速度が速く、カップの内壁面に衝突した際にミストを発生し易く、基板と内壁面との距離が短い場合にミストが発生し易くなるという問題があった。

【0058】しかし、本発明のように、スピン乾燥を内壁面が略乾燥した状態（完全に乾燥しているか、または表面がうっすらと濡れている程度の状態をいう）にある外カップ48で囲繞させて行くと、基板Gを高速回転させることにより発生した気流が外カップ48の内壁面からミストを発生させることが殆どない。また、処理カップユニット49の構造上、基板Gの回転数が高速になるにつれて、基板Gと基板Gから飛散する処理液を受け止めるカップ（外カップ48）の外周壁の内壁面との距離が長くなるために、発生した気流が弱められて内壁面に達することによってもミストの発生が防止される。さらに、スピン乾燥時には、基板と外カップ48の外周壁の内壁面との距離が長いことから、基板から飛散する処理液は速度が低減されて内壁面に衝突し、または直接に吸気口91内へ導入されることからミストの発生が防止される。

【0059】さらにまた、内壁面に現像液やリンス液が付着した内カップ46や中カップ47には基板Gの周りに発生する強い気流が直接には当たらないことからミストの発生が防止される。こうしてスピン乾燥時に発生するミスト量が顕著に低減され、基板Gにミストがパーティクルとして付着することが抑制される。加えて、排気機構90による側面排気によってもミストが回収されるために、基板Gへのパーティクルの付着が抑制される。

【0060】スピン乾燥処理時に乾燥した内壁面を有する外カップ48を用いることと排気機構90を用いて側面排気を行うことは、それぞれが独立して、ミストの低減やパーティクルの基板Gへの付着抑制に効果があるが、両者を併用することによりその効果をさらに高めることができる。

【0061】スピン乾燥が終了した後は、基板Gの回転を停止し（ステップ12）、スピンチャック41を上昇させ（ステップ13）、そのタイミングに合わせて搬送アーム19aを現像処理ユニット（DEV）24a～24c内に挿入して、基板Gの受け渡しを行う（ステップ14）。基板Gの回転終了後から基板Gの搬送アーム19aへの受け渡しに至る間に、排気機構90の動作を停止し、次処理に備える。

【0062】ステップ14が終了してスピンチャック41に基板Gがない状態においては、処理カップユニット

49は下段位置にあることから、ステップ1の状態が満足されていることになる。また、次に処理すべき基板Gが搬送アーム19aにより現像処理ユニット(DEV)24a~24c内に搬送されれば、ステップ2以降の前述した工程に従って基板Gの現像処理を継続して行うことができる。ステップ14の後に現像処理を終了する場合には、基板Gを現像処理ユニット(DEV)24a~24c外へ搬出した後に、スピチャック41を降下させて処理カップユニット49内にスピチャック41を収納する。

【0063】以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明が上記形態に限定されるものでないことは言うまでもない。例えば、基板Gを保持する手段としては、上記実施形態のように、基板Gを吸着力により保持するスピチャック41に限定されず、例えば、基板よりも大きなスピプレート上に凸に形成された複数の固定ピン上に基板を載置して、基板を回転させた際に基板Gの位置がずれないように、基板Gの端面の所定位置、例えば、4隅において基板Gを別のピン等で保持するメカニカルな方法を用いることもできる。

【0064】また、現像処理工程においては、処理カップユニット49を昇降させて現像液の振り切り、リンス処理、スピ乾燥時の位置調整を行ったが、処理カップユニット49を固定として、スピチャック41を昇降させて所定位置に保持しながら、現像液の振り切り等の処理を行うことも可能である。

【0065】さらに、上記実施形態ではLCD基板のレジスト塗布・現像処理システムにおける現像処理ユニットに本発明の液処理装置を適用した場合を例に説明したが、本発明は現像処理ユニットに限られるものではなく、他の液処理装置にも適用することができる。例えば、本発明の液処理装置を、レジスト塗布・現像処理システムにおける洗浄処理ユニット(SCR)21a・21bやレジスト塗布処理ユニット(CT)22に適用することができる。また、被処理基板としてLCD基板について説明してきたが、半導体ウエハ、CD基板等の他の基板についても用いることが可能である。

【0066】

【発明の効果】以上の説明の通り、本発明の液処理装置および液処理方法によれば、液処理中に処理液のミストが発生しても、カップの外周壁に設けられた排気機構によって排気されることから、ミストの基板上空への舞い上がりが防止され、基板へのパーティクルの付着を防止することが可能となる。排気機構は基板の回転によって生ずる気流を順方向で吸引することから、効率よく排気を行うことができる。

【0067】また、スピ乾燥時は、内壁面がほぼ乾燥した状態にあるカップにより基板の外周が囲繞されていることから、基板を高速回転させた場合に発生する気流が内壁面に付着している処理液からミストを発生させる

ということがなく、これによりミストの発生が防止される。さらに、基板Gの回転数が高速になるにつれて、基板と基板から飛散する処理液を受け止めるカップの内壁面との距離が長くなるために、発生した気流が弱められて内壁面に達することによっても、ミストの発生が防止される。さらにまた、内壁面に現像液やリンス液が付着した内カップや中カップには基板のスピ回転時に基板の周りに発生する強い気流が直接には当たらないことからミストの発生が防止される。

10 【0068】このように、本発明によれば、液処理時におけるミストの発生が防止され、また、ミストが発生した場合であっても効率的にミストが排気されることから、基板の上空へ舞い上がるミスト量が低減され、基板へのパーティクルの付着量が低減される。こうしてパーティクルの付着量の少ない高い品質の基板を得ることが可能となり、製品不良の低減によって歩留まりが向上し、高い信頼性が確保されるという顕著な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

20 【図1】本発明の液処理装置が用いられるレジスト塗布・現像システムの一実施形態を示す平面図。

【図2】本発明の液処理装置に係る現像処理ユニットの一実施形態を示す断面図。

【図3】本発明の液処理装置に係る現像処理ユニットの一実施形態を示す平面図。

【図4】本発明の液処理装置に係る現像処理ユニットに用いられる現像液吐出ノズルの一実施形態を示す斜視図。

30 【図5】本発明の液処理装置に係る現像処理ユニットの制御系の一実施形態を示す説明図。

【図6】本発明の液処理方法の一実施形態である現像処理工程の一例を示す説明図。

【図7】本発明の液処理装置に係る現像処理ユニットを用いた現像処理工程における処理カップユニットの位置の移動形態を示す説明図。

【符号の説明】

1；カセットステーション

2；処理部

3；インターフェイス部

40 24a~24c；現像処理ユニット(DEV)

41；スピチャック

46；内カップ

47；中カップ

48；外カップ

49；処理カップユニット

50 50；昇降駆動機構

57；姿勢制御ピン

89；排気口

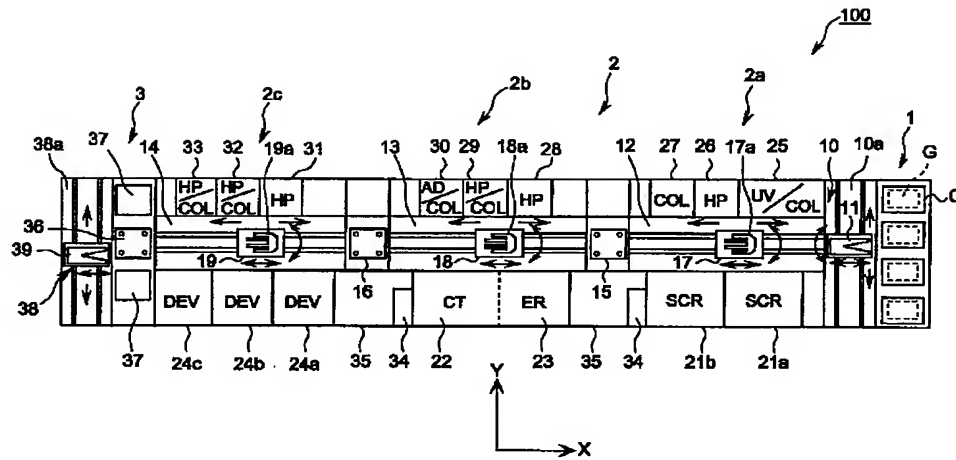
90；排気機構

91；吸気口

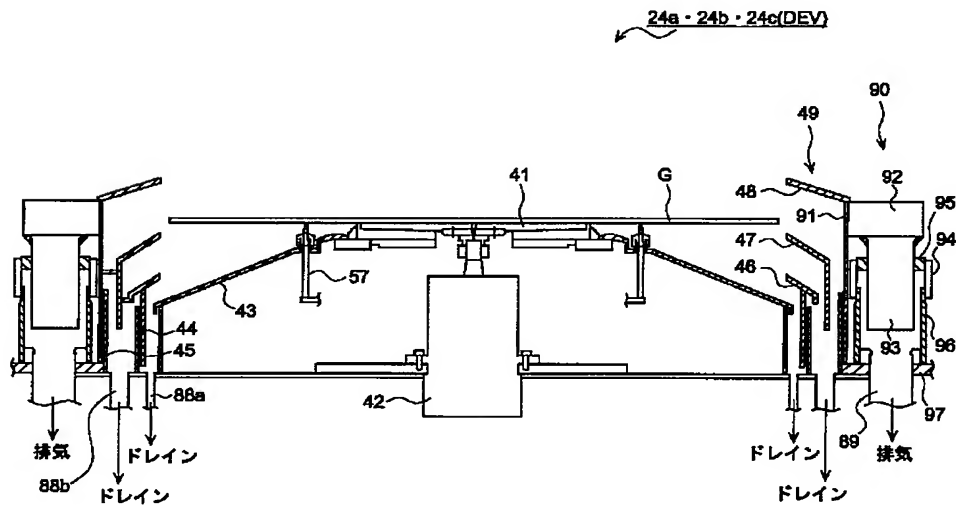
92 ; 第1導入管
93 ; 第2導入管
94 ; 蛇腹部材
95 ; 固定部材

* 96 ; 壁部
97 ; 底板
100 ; レジスト塗布・現像処理システム
* G ; 基板 (被処理基板)

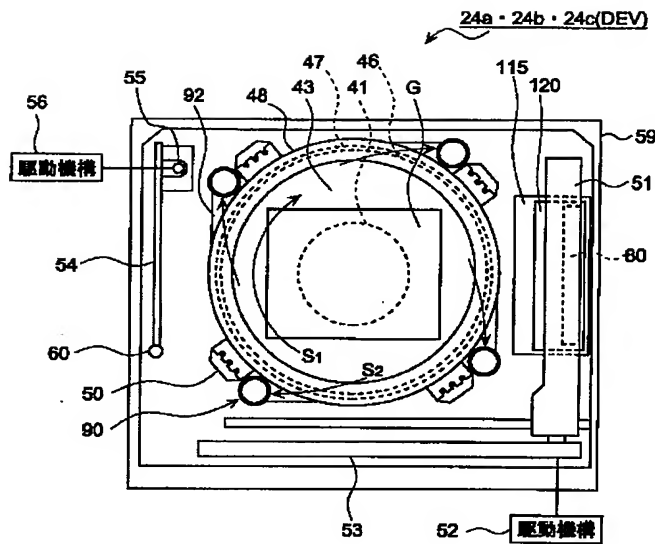
【図1】



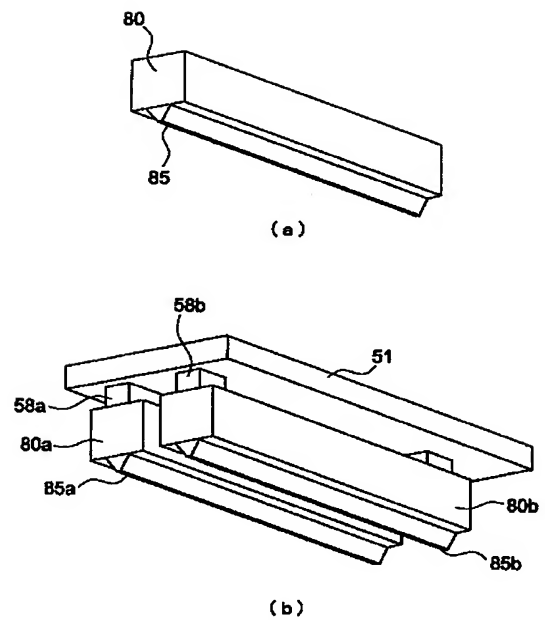
【図2】



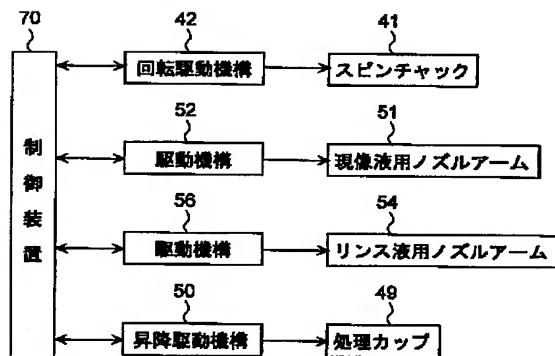
【図3】



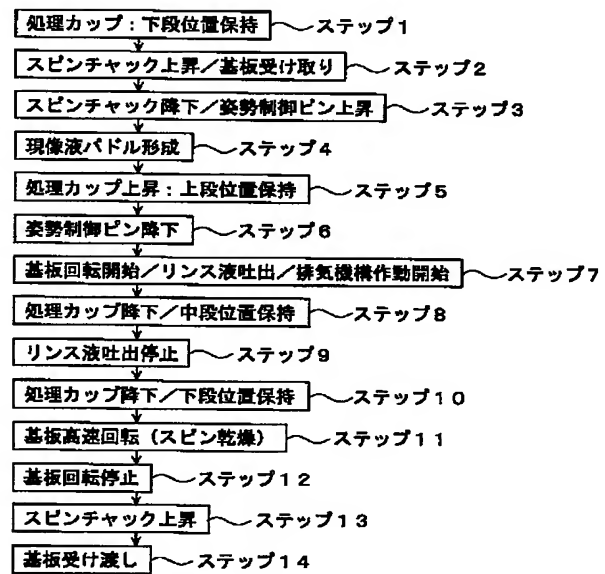
【図4】



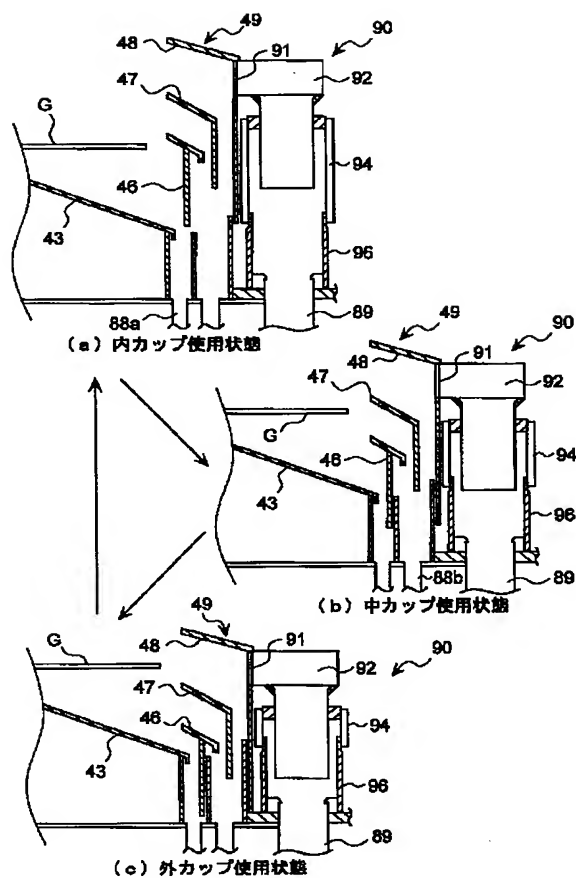
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H088 FA17 FA18 FA21 FA30 HA01
 MA20
 4D075 AC65 AC73 AC79 AC88 AC97
 BB24Z BB57Z CA48 DA06
 DB13 DC22 DC24 EA45
 4F042 AA02 AA07 AA10 EB06 EB13
 EB18 EB23 EB24